





1、熟悉显微硬度计的基本原理和构造。
 2、掌握显微硬度计使用和维护方法。
 3、初步掌握相鉴定方法(以高碳高硼高速钢为例)。

二、显微硬度测试原理

硬度:材料在一定条件下抵抗另一本身不发生残余变形物体压入能力。抵抗能力愈大,则硬度愈高,反之则硬度愈低。

显微硬度应用场合:测定<u>某个相、某个晶粒、夹杂物</u>或 其他组成体;扩散层组织、<u>偏析相、硬化层深度</u>以及<u>极薄层</u> 试样。

显微硬度的表征方法:载荷和压痕面积之比值。 分类:维氏和努氏。





三、显微硬度计的工作原理及组成



四、显微硬度计的正确使用

1、功能键介绍

401MVD的 前面板



START	开始键
ОК	确认键
ESC	退出键
DELETE	清除键
DWELL	保载时间设定键
SETUP	糸统设置键
ZERO	归零键
PRINT	数据输出键

HARDNESS CONVERSION HARDNESS SCALL HV/HK/HB FORCE UNIT(gf) (mN) DATA OUTPUT LCD BRIGHTNESS LANGUAGE DATE/TIME SELECT 1K/2K

SELECT: **†** CONFIRM:OK RETURN:ESC

<delete Menu>



<DWELL MENU>

DWELL(S): 5 INCREASE | KEY DECREASE | KEY

CONFIRM:OK RETURN:ESC

<SETUP MENU>

HARDNESS CONVERSION HARDNESS SCALL HV/HK/HB FORCE UNIT(gf) (mN) DATA OUTPUT LCD BRIGHTNESS LANGUAGE DATE/TIME SELECT 1K/2K

SELECT: ↑↓CONFIRM:OK RETURN:ESC

HARDNESS CONVERSION

HARDNESS CONVERSION

ISO(DIN) ASTM

SELECT: **11CONFIRM:OK RETURN:ESC**

HARDNESS CONVERSION HV TO: HV(H) HK(H) HBS(H) HBW HRA(H) HRC HRB(H) HRD 15N 30N 45N HS(H) TSA(H) HV(S) HK(S) HBS(S) HRB(S) HRF HRG HRE HRK 15T 30T 45T HS(S) TSA(S)

SELECT: ↑↓CONFIRM:OK RETURN:ESC

HARDNESS SCALE HV/HK/HB

HARDNESS SCALE

HV HK HB

SELECT: ←→CONFIRM:OK RETURN:ESC

FORCE UNIT



LIMITS GO/NG

SELECT: ↑↓CONFIRM:OK RETURN:ESC

DATA OUTPUT

DATA OUTPUT

TO INTERNAL PRINTER TO RS232/TEST RESULT ONLY TO RS232/TEST RESULT+STAT'S

SELECT: CONFIRM:OK RETURN:ESC

LCD BRIGHTNESS



LANGUAGE

LANGUAGE ENGLISH FRANCAIS ESPANOL CHINESE

DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS JAPANESE

SELECT: ↑↓CONFIRM:OK RETURN:ESC

DATE/TIME



<ZERO>

O.OHV0.5CONVERSION:HRCD1:0.0umT.FORCE(gf):500D2:0.0um

LIMITS: 700.0

600.0 NG

SET DIGITAL ENCODER TO ZERO

<PRINT>

2	∂	
	TEST NO DATE :10-10-10 TIME : 17.21 HV1.000	A REAL
X	X :730.3 NO :9 S.DEV :17.4 MAX :765.1 MIN :700.5 R :64.6	
21	XCON 61.3HRC LIMIT :735.0 LIMIT :715.0 HV1.000 1 718.9 GO	-VZ -St
KK.	2 735.3 NG 3 721.4 GO 4 700.5 NG 5 729.5 GO 6 765.1 NG 7 722.0 GO	No. 15
G	8 746.2 NG 9 734.1 GO	all the

在测试开始之前,如何制备试样?

1、试样在制备过程中,应尽量避免由于受热、冷加工
 等对试样表面硬度的影响。

试样的试验面为光滑平面,不应有氧化皮及其他污染物。试样的表面粗糙度应不大于0.1μm。测定全相组织硬度的试样最好电解抛光。

3. 对于微小截面或异形试样,应进行镶嵌或用特殊夹具 夹持,但这些方法不得影响试验结果的准确性。

表面层

基体

t<T/10

Т

在测试开始之前,如何选择负荷大小?

在测定薄片或表面层硬度时,根据压头压入深度和试件或表面层厚度
 选择负荷。为避免底层硬度的影响,压头压入深度应小于试件或表面层
 的十分之一。

试样

t<T/10

在测试开始之前,如何选择负荷大小?

2、对试样剖面测定硬度时,应根据压痕对角线长度和剖面宽度选择负荷。 压痕中心离开边缘的距离应不小于压痕对角线长度的2.5倍,即压痕对角 线长度为试件或表面层剖面宽度的五分之一。

d

D

D≥2.5d

在测试开始之前,如何选择负荷大小?

3、测定试件(零件、表面层、材料)平均硬度时,在试件表面尺寸及厚度允许的前提下,应尽量选择<u>大负荷</u>,以免试件材料组织硬度不均匀影响试件硬度测定的正确性。

4、为保证测量精确度,在情况允许时,应选择<u>大负荷</u>,一般应使压痕对 角线长度大于20µm。

5、考虑到试件表面冷加工时产生的挤压应力硬化层的影响,在选择负荷 时应在情况许可的情况下选择<u>大负荷</u>。



Step1:按下电源开关上的"l"标记,打开硬度计电源,采统会发出"嘀 嘀"的声音并在屏幕上显示WOLPERT的商标约3秒钟。 接着采统显示主菜单,这表明采统经检测正常。

WILSON WOLPERT

Step2: 通过试验力变换手轮选择试验力。系统会自动判断当前的标尺 选择并显示在主菜单上,按<OK>确认。

Step3: 按<DWELL>改变保载时间。



Step4: 按<SETUP>进入系统设置菜单进行参数设置。

Step5:进行测微目镜归零操作。

Step6:把试件放在工作台上,把转台上的40X物镜回转到工作位置。 移动试件,使之刚好在40X物镜下方。顺时针旋转调焦手轮, 升起升降轴,进行调焦。
Step7:把压头回转到工作位置,准备进行测试。
Step8:按下<START>进行测试。

ROTATE TURRET TO INDENTER POSITION

PRESS OK TO CONFIRM PRESS START TO PROCEED Please wait.....

TESTING



Step10:记录显微硬度值,并输出实验结果值。

相的鉴定

表:合金成分						
元素	C	В	Cr	W	Мо	V
含量	0.9-1.0	1.0-1.2	<5.0	<2.0	<2.0	<2.0
元素	Si	Mn	S	Р	Fe	
含量	0.5	0.6-0.8	<0.04	<0.05	Bal.	



相的鉴定



	D1	D2
Elmt	Element %	Element %
СК	12.10	10.09
Si K	2.88	0.37
VK	0.19*	0.90
CrK	2.39	6.26
Fe K	80.76	75.18
Ni K	1.67	0.78
WK	-	6.42
Total	100.00	-100.00



	D1	D2	D3
Elmt	Element %	Element %	Element %
C K	14.31	12.54	17.63
Si K	0.50	0.83	3.46
VK	0.62	0.65	0.27*
Cr K	5.08	4.71	1.99
Fe K	75.56	77.64	75.24
Ni K	1.05	0.98	1.93
WK	2.88	2.65	-0.53*
Total	100.00	100.00	100.00

相的鉴定





1135 HV0.1 855.2HV0.1

相的鉴定



铁素体 (100X)



下贝氏体(1500X)



臭氏体(500X)



板条状马氏体(500X)



片层珠光体(500X)



针状马氏体(500X)

附:《显微硬度实验》实验报告





